

北京赛微电子股份有限公司

关于全资子公司 MEMS-OCS 启动量产的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，北京赛微电子股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司 Silex Microsystems AB（以下简称“瑞典 Silex”）以 MEMS（Micro-Electro-Mechanical Systems 的缩写，即微电子机械系统，简称为微机电系统）工艺为某客户制造的 OCS（Optical Circuit Switch 的缩写，即光链路交换器件）完成了工艺及性能验证（工艺开发与试产的总耗费时间超过 7 年），并于 2023 年 12 月 22 日收到该客户发出的批量采购订单，瑞典 Silex 开始进行 MEMS-OCS 的商业化规模量产。

该 MEMS-OCS 基于 8 英寸 MEMS 工艺和设计技术制造，结构复杂精密，是一组由指定数量平面镜所构成的微镜阵列，可用于精确调节光链路的折射方向，实现光链路之间的信号切换与双向传播，提高运算系统的整体性能及稳定性，同时降低系统成本与功耗，可在数据中心网络、超算系统集群等场景中得到广泛应用。

公司全资子公司瑞典 Silex 是全球领先的纯 MEMS 代工企业，2019-2022 年在全球 MEMS 纯代工厂商排名中位居第一，在 2022 年全球 MEMS 厂商综合排名中居第 26 位。（根据半导体市场研究机构 Yole Development 的统计数据）

公司是全球领先、国际化运营的高端集成电路芯片晶圆制造厂商，也是国内拥有自主知识产权和掌握核心半导体制造技术的特色工艺专业芯片晶圆制造商。公司在国内外布局多座中试平台及量产工厂，致力于为全球通信、生物医药、工业汽车、消费电子等各领域客户提供优质的 MEMS 工艺开发及晶圆制造服务。

根据产业发展规律及公司境内外产线的实际运营经验，不同类别 MEMS 芯片一般都需要经历从工艺开发到风险试产、规模量产的过程，所耗时间存在差异。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

北京赛微电子股份有限公司董事会

2023年12月24日